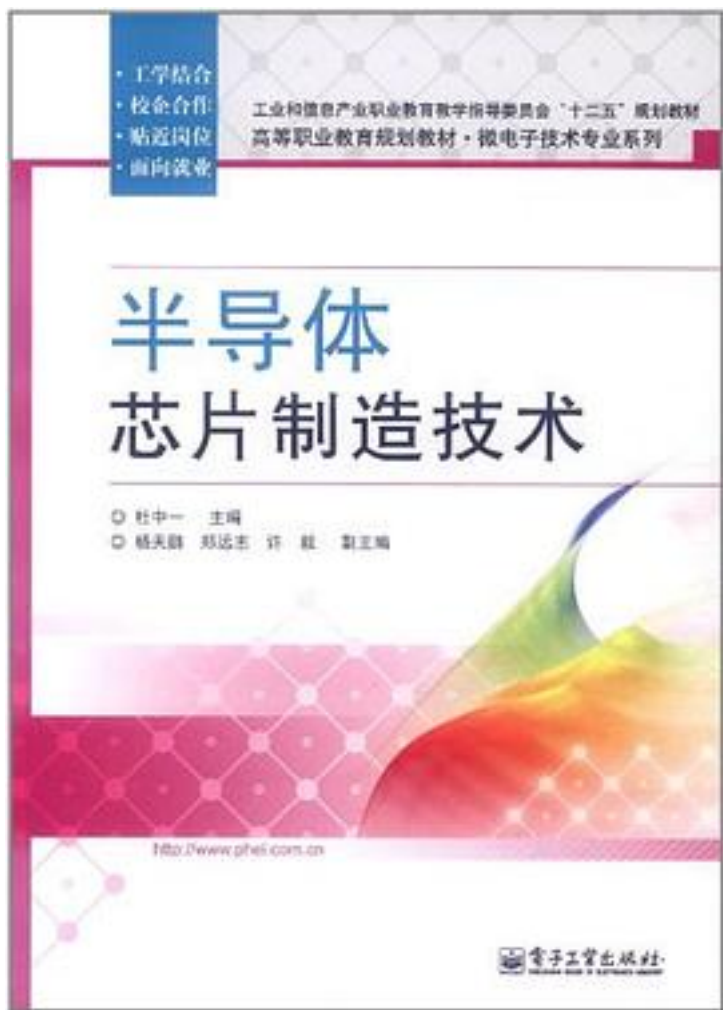


半导体芯片制造技术



[半导体芯片制造技术_下载链接1](#)

著者:杜中一

出版者:电子工业出版社

出版时间:2012-2

装帧:

isbn:9787121153969

《半导体芯片制造技术》全面系统地介绍了半导体芯片制造技术，内容包括半导体芯片

制造概述、多晶半导体的制备、单晶半导体的制备、晶圆制备、薄膜制备、金属有机物化学气相沉积、光刻、刻蚀、掺杂及封装。书中简要介绍了半导体芯片制造的基本理论基础，系统介绍了多晶半导体、单晶半导体与晶圆的制备，详细介绍了薄膜制备、光刻与刻蚀及掺杂等工艺。由于目前光电产业的不断发展，对于化合物半导体的使用越来越多，《半导体芯片制造技术》以半导体硅材料芯片制造为主，兼顾化合物半导体材料芯片制造，比如在介绍薄膜制备工艺中，书中用单独的一章介绍了如何通过金属有机物化学气相沉积来制备化合物半导体材料薄膜。

《半导体芯片制造技术》针对高职高专学生的特点，以“实用为主、够用为度”为原则，系统地介绍了半导体芯片制造技术。《半导体芯片制造技术》可作为微电子、光电子、光伏、电子等相关专业高职高专的教材，也可作为相关专业学生和技术人员的自学参考用书。

作者介绍:

目录:

[半导体芯片制造技术_下载链接1](#)

标签

芯片

半导体

CPU

2019

评论

书比较一般。但通过书中传达的框架，再查阅其他资料，从而学到了很多。

foundry使用各种自然科学，越向上硬件软件越抽象。ic从业人员应该一读。

[半导体芯片制造技术_下载链接1](#)

书评

近年来，中兴、华为等本土高科技企业相继受到芯片制裁，芯片制造再次成为一个备受国人关注的话题。芯片产业链可以大体分成：设计、制造、封装、测试、设备和材料等领域。目前，在芯片设计领域，海思、紫光等国内企业已经开始在细分市场占据一席之地；在芯片封测领域，长电、华...

[半导体芯片制造技术_下载链接1](#)